

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

機關傳真：29387749

承辦人：陳瑞英

聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國106年9月8日

發文字號：政研發字第1060026636號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：科技部函、徵求公告、說明會資訊、業界合作意願書、申請人承諾書、研究領域一說明、研究領域二說明、研究領域三說明、研究領域四說明、研究領域五說明、工程司總子計畫合併參考範例

主旨：科技部公開徵求107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，校內線上截止收件時間為106年11月14日（星期二）下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依科技部106年9月7日科部工字第1060070326號函辦理。
- 二、科技部配合國家政策投入研發資源，本計畫規劃將整合學界研發能量與資源，鼓勵學術團隊參與，並與產業共同合作，建立關鍵自主技術及增加附加價值，希冀達到垂直整合現有相關產業需求，帶動產業發展，以提升半導體領域之國際競爭優勢。
- 三、科技部訂於106年9月13日、9月15日、9月19日於北、中、南舉辦說明會，有意參與者，請逕至報名系統 (<https://goo.gl/8JkhV2>)完成報名。
- 四、申請重點提醒如下：
 - (一) 規劃四年(自107年3月1日至111年2月28日)計畫，每年度申請總額以不超過2,200萬元為原則(如欲申請購置單價新臺幣500萬元(含)以上之大型儀器，申請總額以不超過2,600萬元為原則)。
 - (二) 科技部核給研究主持費最高每個月新台幣六萬元，以鼓勵計畫主持人能專注投入執行。
 - (三) 本案為整合型計畫，每一整合型計畫需含總計畫與三個(含)以上之

子計畫，總計畫與各子計畫主持人申請方式如下：

- 1、總計畫主持人須同時主持1件子計畫，請總計畫主持人務必將其總計畫與自身所主持之子計畫合併填寫成一份計畫書，計畫書中須分別陳述總計畫及所屬子計畫之內容，並將總計畫及子計畫之各項申請經費於備註欄分別註明以作區隔。
 - 2、其他各子計畫主持人須個別提出申請書。
- (四) 總計畫與各子計畫主持人於執行本計畫期間，不得執行科技部其他計畫(申請人提計畫書時，須將【承諾書】附於計畫書表CM03 研究計畫內容之後)，惟因本項計畫獲核定之大型儀器計畫不在此限。
- (五) 有關計畫頁數限制請務必依照科技部「專題研究計畫申請書表CM03研究計畫內容頁數限制一覽表」內工程司之規定，超出部分科技部將不予審查。
- (六) 有意申請者，請於旨揭期限前至科技部線上提出申請，計畫類別點選「一般研究計畫」；研究型別點選「整合型計畫」；計畫歸屬點選「工程司」；學門代碼點選「E9853-智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」；子學門代碼請依該計畫所屬領域點選其中之一。線上送出後，請所屬單位於106年11月15日(星期三)中午12點將申請名冊送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。

五、本計畫徵求資訊請至科技部工程司網站 (<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項參閱。計畫申請如有疑慮，請洽科技部潘敏治副研究員，電話：(02)2737-7983。申請系統操作問題，請洽科技部資訊處，聯絡電話：0800-212-058，(02) 2737-7590~92。

正本：本校各院、所、系、中心

副本：研究發展處

校長 周 行 一

檔 號：

保存年限：

科技部 函

機關地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：潘敏治 副研究員

電話：02-2737-7983

傳真：02-2737-7673

電子信箱：mcpan@most.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國106年9月7日

發文字號：科部工字第1060070326號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：本部工程司推動107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，自即日起接受申請，請查照。

說明：

- 一、本計畫申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於106年11月20日(週一)前備函送達本部(請彙整造冊後專案函送，逾期恕不受理)。
- 二、本計畫規劃將整合學界研發能量與資源，鼓勵學術團隊參與，並與產業共同合作，建立關鍵自主技術及增加附加價值。
- 三、計畫之研究主題必須具有前瞻性、關鍵性及創新性，計畫內容必須陳述國內外現狀及所欲達成之技術指標，同時，必須陳述四年計畫規劃藍圖(roadmap)及執行內容，並具體說明階段性成果與後續產業化成效。
- 四、本部對執行計畫每年進行審查，執行團隊必須定期提報計畫執行進度與成果，並出席各項審查會議，各執行團隊須能展示該計畫

所開發之技術或系統成果。

五、本計畫徵求公告相關內容業已公佈於本部工程司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。

正本：國立臺灣大學等303個機構

副本：本部綜合規劃司、工程技術研究發展司



裝

訂

線